第三届功能材料与界面科学大会

第一轮通知

会议介绍 第三届功能材料与界面科学大会由中国颗粒学会主办,电子科技大学、北京理工大学、南京工业大学、江西师范大学、广西民族大学承办,洛阳师范学院、常州大学、河南大学、生化工程国家重点实验室、《Rare Metals》、《中国化学快报》协办,定于 2021 年 10 月 22 日至 10 月 24 日在广西南宁举办。功能材料与界面科学研讨会作为重要的学术交流平台。此前,第一届研讨会于 2019 年 12 月中旬在长沙召开,第二届研讨会于 2020 年 10 月下旬在厦门召开。此次会议将围绕"功能材料与界面科学"主题,针对当前能源、环境、催化、生物、信息等交叉学科中的功能材料及其表界面科学问题展开研讨,促进学科建设发展与科技创新,为国内功能材料及其表界面科学领域学者提供交流平台。会议涵盖的主题包

括无机材料、金属材料、高分子材料、电解质、表界面技术与表征手段等 13 会场(研究生论坛、青年科学家论坛), 预计 600 余报告, 欢迎各位专家学者与研究生交流、各企业参会

会议组织

大会主席: 陈义旺、董晓臣、马建民、王博

大会副主席:王振华、马录芳、任玉荣

参展,为企业界产学研合作提供机会!

组委会成员:白莹、陈立宝、陈仕谋、陈卫华、曹晓雨、陈燕、陈亚楠、陈义旺、崔志明、邓齐波、丁书江、董晓臣、段小川、杜亚平、范修林、付永柱、郭焕芳、葛君杰、高敏锐、郭孝东、何传新、韩冬雪、黄佳琦、霍开富、韩晓刚、胡先罗、侯阳、贺艳兵、黄又举、江浩、纪效波、孔彪、刘宝忠、赖超、李驰麟、李福军、李光琴、连加彪、梁嘉杰、李君涛、刘敏、吕瑞涛、李伟、梁霄、李喜飞、刘宪虎、李新昊、刘新华、刘晓英、李彦光、卢周广、明军、马建民、马录芳、马雯、米艳、牛志强、彭新文、芮先宏、邵明飞、孙文平、陶新永、唐永炳、谭勇文、王宝、王博、王芳、王红强、王接喜、王连军、王强、文锐、吴兴隆、王永刚、王振华、王治宇、谢钢、夏晖、徐林、徐立群、辛森、熊胜林、许运华、徐建铁、杨成浩、晏成林、闫东鹏、尹诗斌、余丁山、余皓、姚宏斌、尉海军、杨金虎、阳军亮、袁明鉴、禹习谦、杨植、朱昌宝、支春义、张军、邹吉军、张佳楠、张进涛、邹建新、张乃庆、曾荣华、周天华、张伟(吉大)、张伟(陕师)、张文超、朱万诚、邹晓新、赵玉峰、邹应萍、张育新、张志成、张振杰、张志佳、张哲旭

秘书: 郭康隆、黄俊达、姜高学、刘建东、戚世瀚、孙怀虎、王川、王华平、吴达雄、武明 光、王文捷、王中升、徐晨轩

会议时间安排

2021年10月22日上午10:00-23:00会议报到

2021年10月23日上午8:00-12:00 开幕式、大会报告

2021年10月23日下午14:00-18:00分会场主题报告、邀请报告

2021年10月24日上午8:00-12:00分会场主题报告、邀请报告

2021年10月24日下午14:00-18:00分会场主题报告、邀请报告

会议前培训课程

2021年10月22日上午8:30-12:30,下午14:00-18:00 电池理论高级课程

会议交费信息

参会人员	9月30号前缴费	9月30号后交费
学生代表	1600 元	2000 元
教师/企业代表	2200 元	2600 元
中国颗粒学会会员减免 200 元,请备注:会员号		

培训收费

人员	电池理论高级课程	
研究生及青年教师	1200 元	

支付方式

1. 银行汇款

开户行:中国民生银行股份有限公司南宁分行营业部

汇款账号: 632359023

收款单位:广西沃顿国际大酒店有限公司 2. 微信/支付宝转账:扫描下方二维码



(注明: 参会人姓名+单位+功能材料)

3. 现场缴费 刷卡或现金

会议推荐酒店

- 1. 广西沃顿国际大酒店(会场酒店)预定电话: 0771-2111862
- 2. 南宁亚朵精品连锁酒店南湖店(距离会场酒店 5 分钟) 预定电话: 0771-5538999

交通: 1. 机场: 酒店有城市候机楼、机场直达大巴(机场——沃顿国际大酒店)(沃顿国际大酒店——机场); 乘民航大巴 2 号线直达到酒店(20 元/人), 半小时发车一趟、最早一趟是发车是 05:30AM、最晚一趟是 23:00PM;

- 2. 南宁火车站:可坐地铁 1 号线 (到南湖站下——从 B2 出口出),直走 100 米到广西沃顿国际大酒店。
- 3. **南宁火车东站**: 可坐地铁 1 号线(到南湖站下——从 B2 出口出)直走 100 米到广西沃顿 国际大酒店。

会议联系人

会议注册事宜

吴达雄 电话: 18312801355; 邮箱: wudaxiong@hnu.edu.cn 姜高学 电话: 15069081163; 邮箱: jianggx@hnu.edu.cn

会议赞助事宜

武明光 电话: 15675117382; 邮箱: ming3016@hnu.edu.cn

第三界功能材料与界面科学大会组委会